



La Chine peut désormais initier son adoption du SOI

Selon Soitec, l'industrie chinoise peut désormais bénéficier des offres technologiques des fonderies et du support de l'industrie des concepteurs de puces électroniques

SHANGHAI, Chine - 19 mars 2008 - Soitec (Euronext Paris), premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI) et de substrats innovants, a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse au salon Semicon China, que **l'industrie du SOI offre à ce jour à l'industrie chinoise, tant au niveau de la conception des puces électroniques que de leur fabrication, des conditions idéales pour une intégration du SOI dans son offre technologique.**

Le SOI est utilisé aujourd'hui dans un nombre croissant d'appareils électroniques pour une large variété d'applications, allant du monde de l'automobile jusqu'à des produits mobiles grand public. Les puces électroniques à base de SOI sont économiquement rentables à fabriquer tout en étant plus puissantes et performantes. La convergence qui existe aujourd'hui entre **la maturité technologique de la Chine et de celle de l'industrie des concepteurs de puces à base de SOI et des fabricants peut faciliter la conversion au SOI des fonderies et sociétés de conception de puces chinoises** (dites « fabless »).

« *C'est le moment propice pour l'industrie chinoise des semi-conducteurs, qui possède un formidable potentiel, de tirer parti des avantages exceptionnels du SOI. Mais pour que la Chine s'aligne avec les leaders de l'industrie, les fonderies et les sociétés « fabless » chinoises doivent initier dès maintenant des premières actions* », explique André-Jacques Auberton-Hervé, Président-Directeur général du Groupe Soitec.

« *En tant que membre fondateur du Consortium industriel SOI*, Soitec travaille avec 21 entreprises leaders pour accompagner l'accélération de l'innovation du SOI sur de nombreux marchés et lever les freins à son adoption. Les concepteurs et fabricants de puces électroniques en Chine devraient être les premiers bénéficiaires de cette initiative et nous comptons avancer ensemble dans cette transition* », explique André-Jacques Auberton-Hervé.

Soitec, qui s'est engagé à répondre à la demande actuelle et future en SOI de l'Asie, est en phase de qualification dans sa nouvelle usine de fabrication de plaques de SOI en taille 300-mm, à Pasir Ris 1, usine récemment construite à Singapour pour alimenter le marché asiatique en pleine croissance.

Notes aux rédacteurs à propos du SOI : *La plupart des puces électroniques sont fabriquées à partir de plaques de silicium. Le silicium sur isolant ou SOI (Silicon-On-Insulator) désigne un type particulier de plaques de silicium dans laquelle une couche d'isolation est ajoutée juste en dessous de la couche en surface. Les entreprises leaders de l'industrie utilisent ces plaques de SOI pour fabriquer des puces destinées aux ordinateurs, consoles de jeux, appareils de télécommunications, applications automobiles et industrielles, etc. S'ils choisissent de fabriquer leurs puces à partir de plaques SOI plutôt que de plaques de silicium traditionnel, c'est essentiellement parce que la couche d'isolation ajoutée évite la déperdition de courant électrique. De ce fait, les puces à base de silicium sur isolant sont 30 % plus rapides et consomment deux fois moins d'électricité. Soitec détient un procédé breveté appelé Smart Cut™ qui sert à fabriquer la plupart des plaques de SOI fabriquées dans le monde.*

* www.soiconsortium.org

Pour toute information, merci de contacter:

Relations Presse – H&B Communication

Marie-Caroline Saro – Nadège Chapelin – Tel. 33 (0)1 58 18 32 44 / 45
Email : mc.saro@hbcommunication.fr

Soitec

Camille Darnaud-Dufour - Directrice de la Communication – Tel. 33 (0)6 79 49 51 43
Email : camille.darnaud-dufour@soitec.com



À propos du Groupe Soitec :

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr

Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.